

### 반도체공정 및 장비 연계전공 교과과정

○ 학위명 : 반도체공정 및 장비학사(Semiconductor device process)

전공영역	학수번호	교과목명	학점	설강계획					
				1학기	하계 계절	2학기	동계 계절		
전공핵심	연계학과 교과과정표 참고	신소재공학과 5과목	9학점 이상						
		전자공학과 20과목							
		정보통신공학과 12과목							
		화학공학과 10과목							
		고분자공학과 10과목							
		물리학과 13과목							
개론	MSE2102	반도체공정 및 장비 개론	3			○			
공통	MSE2104	LINC+세미나	3	○					
pre-PSP 모듈	모듈 1	MSE3103	반도체공학	12학점 이상	○				
		MSE3122	반도체공정실습			○			
		MSE3121	반도체공정설계				○		
		MSE3123	pre-PSP 반도체					○	
	모듈 2	MSE3104	디스플레이공학		○				
		MSE3125	디스플레이공정실습			○			
		MSE3124	디스플레이공정설계				○		
		MSE3126	pre-PSP 디스플레이						○
	모듈 3	MSE3106	반도체장비부품설계		○				
		MSE3144	반도체장비실습			○			
		MSE3143	반도체장비요소기술				○		
		MSE3128	pre-PSP 장비부품						○
PSP모듈	MSE4106	반도체공정 및 장비 PBL	6	○					
	MSE4107	반도체공정 및 장비 PSP 기술연구			○				

○ 전공핵심 교과목

연계학과	전공핵심
신소재공학과	전자재료물성(3), 나노물성 및 합성(3), 반도체공정(3), 박막공학(3), 반도체소자(3)
전자공학과	회로이론2(3), 전자전기물성(3), 전기자기학2(3), 전자회로2(3), 아날로그회로설계(4), 반도체소자1(3), 반도체소자2(3), 반도체물성(3), 광전자(3), 전자디스플레이(3), MEMS개요(3), 디바이스활용기술(3), 유기전자공학설계(3), 디스플레이공학설계(3), FPGA를 이용한 디지털시스템설계(4), 전자응용실험(1), 전자응용실험2(1), 혼성신호집적회로설계(4), 집적회로공정(3), VLSI설계및프로젝트실습(4)
정보통신공학과	반도체소자(3), 전자회로2(3), 집적회로공학설계(4), 컴퓨터구조론(3), 디지털시스템설계(4), 디지털집적회로설계(4), 전기자기학2(3), 광통신공학설계(4), 광집적회로(3), 광전자소자(3), 수치해석(3), 확률변수론(3)

화학공학과	재료과학(3), 열전달(3), 전기화학공학(3), 반도체공정공학(3), 나노공학(3), 유기반도체물리(3), 컬러링소재(3), 유기발광소자디스플레이(3), 기능성고분자(3), 유기광전자재료(3)
고분자공학과	재료과학(3), 고분자물리화학(3), 무기화학(3), 고분자물성(3), 고분자프로세싱(3), 유기재료합성(3), 기능성신소재(3), 나노공학(3), 신소재분광분석(3), 고분자재료(3)
물리학과	현대물리학1(3), 현대물리학2(3), 전자물리학및실습(3), 기하광학(3), 물리광학(3), 레이저광학(3), 광자응용광학(3), 신소재물리학(3), 고체물리학(3), 반도체물리학(3), 첨단물성물리학(3), 물리와코딩실습(3), 고급열및통계역학및실습(3)